STANDARDLAGENAUFBAU HDI

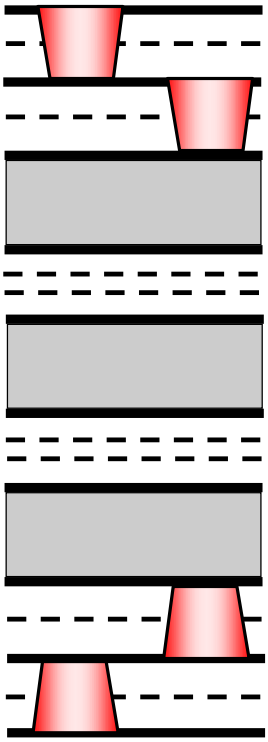
HDI10_2+6+2_1,50_35

10 - Lagen

Kerne: 0,25 mm Cu 35/35 µm

WE-Artikel Nr.:		**2 + 6 + 2**
KUNDE:		

WÜRTH ELEKTRONIK

LAGENBEZEICHNUNG KUNDE	LAGENBEZEICHNUNG WE	AUFBAU	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE [µm]	KUNDEN-FORDERUNG [µm]
1	TOP/VS		Folie	12 µm	1)	**12**	
					1 x 1080	**60**	
2	VSK1		Folie	12 µm		**30**	
					1 x 1080	**60**	
3	2			35 µm		**33**	
			0,250 mm			**250**	
4	3			35 µm		**33**	
					2 x 1080	**124**	
5	4			35 µm		**33**	
			0,250 mm			**250**	
6	5			35 µm		**33**	
					2 x 1080	**124**	
7	6			35 µm		**33**	
			0,250 mm			**250**	
8	7			35 µm		**33**	
					1 x 1080	**60**	
9	RSK1		Folie	12 µm		**30**	
					1 x 1080	**60**	
10	BOT/RS		Folie	12 µm	1)	**12**	
			1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 55 µm				
			Gesamtdicke Material:			1520	
			Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)				

MATERIALDICKE:	**1,50**	+/-	0,13	mm		Datum:	Bearbeiter:
DICKE über galv. Endoberfläche	1,59	+/-	0,16	mm			
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,65	+/-	0,18	mm			
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:		

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision		
27.03.2006	**S. Keller**	04.05.2006	M.Kress	04.05.2006	R. Schönholz	00	Seite:	7+